

# 白金測温抵抗体素子

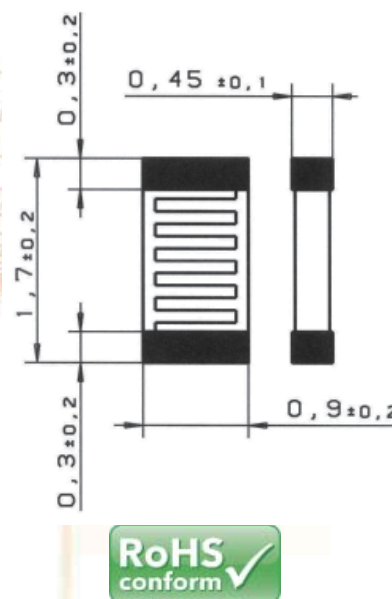
# Heraeus

## SMD 0603 (V)

SMD0603 は低価格で、長期安定性と互換性を求められるプリント基板向けです。また自動実装向けにご使用頂けます。

公称抵抗値 (0°C)	公差 DIN EN 60751 1996-07	公差 DIN EN 60751 2009-05	品番 プリスターリール
1000 Ohm	クラス 2B クラス B	F 0.6 F 0.3	32 207 637 32 207 638

規格	DIN EN 60751	
公差	F 0.3 (クラス B) : $R_0: \pm 0.12\%$ F 0.6 (クラス 2B) : $R_0: \pm 0.24\%$	
温度範囲	-50°C ~ +150°C (使用される基盤素材の膨張が素子と同等であれば +150°C まで使用可能、そうでない場合は +130°C まで使用可能)	
温度係数	TCR = 3850 ppm/K	
接続端子	ガルバニックスズめつき端子 (ニッケル層)	
長期安定性	130°C で 250 時間使用後、最大ドリフト 0.06%	
素子保管条件	乾燥雰囲気	
絶縁抵抗	20°C で 100MΩ 以上、150°C で 2MΩ 以上 (ガラス層カバー)	
測定回路電流	1000Ω : 0.1 ~ 0.3mA (これ以上の電流値では自己発熱による誤差が生じる 可能性があります。)	
自己発熱係数	0°C で 0.8 K/mW	
応答性	水中 (流速 0.4m/s)	$t_{0.5} < 0.1s$ $t_{0.9} < 0.25s$
	空气中 (流速 2m/s)	$t_{0.5} < 2.5s$ $t_{0.9} < 8s$
プロセス方法	表面実装 : リーフローはんだ、またはウェーブはんだ (例 : 235°C において 8 秒以下のダブルウェーブ)	
保管可能期間	乾燥した環境下において最低 9 か月	
パッケージ	プリスターリールに 4000 個	
備考	各種公差や抵抗値についてはご相談に応じます。	



※このデータシートの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。技術データはガイドラインであり、特定の製品の特性を保証するものではありません。

お問い合わせ先:  
ヘレウス株式会社  
ヘレウス ネクセンソス部  
〒112-0012 東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル5F  
Tel: (03)6902-6596 Fax: (03)6902-6599  
Mail: nexensos.japan@heraeus.com URL: www.heraeus.co.jp

03/2019 Printed in Japan

All rights reserved by Heraeus Nexensos GmbH, 03/2019

## SMD タイプセンサのはんだぬれ性テスト

### アセンブリの条件

PCB のレイアウト  
テストに使用した PCB の表面  
ソルダーペースト

150µm ベンチマーク II (材料: FR4 35µm Cu、サイズ 190.5 x 127 x 1.5mm)  
chem. Ag, Cu OSP, NiAu, chem. Sn  
F640 SA30C5-89 M30 (材料: SnAgCu 96.5/3.0/0.5)

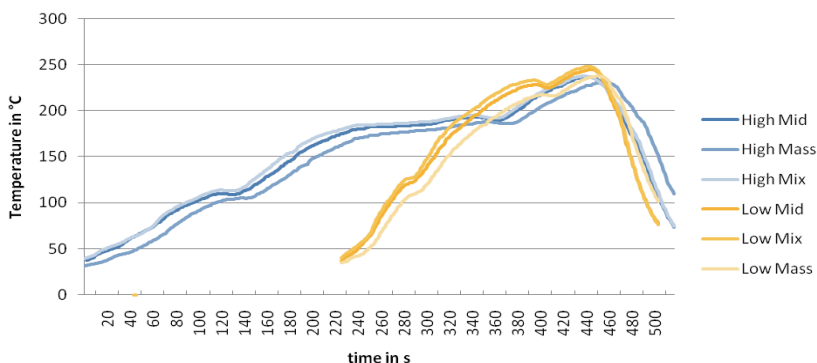
### テストに使用する素子

Pt 1000 SMD-V 0603  
Pt 1000 SMD-V 0805  
Pt 1000 SMD-V 1206

### はんだ条件

プロファイル 高温 (青色)、低温 (黄色)  
雰囲気 窒素、空気

Profiles High and Low



	ピーク (最高温度)		217°C以上の時間 (秒)	
	High	Low	High	Low
Mid <sup>1</sup>	237°C	245°C	60	92
Mass <sup>2</sup>	231°C	238°C	49	68
Mix <sup>3</sup>	238°C	248°C	65	103

<sup>1</sup>Mid PCB の中央に測温抵抗体素子を配置  
<sup>2</sup>Mass PCB の大部分に測温抵抗体素子を配置  
<sup>3</sup>Mix PCB の左右両端にそれぞれ1つずつ測温抵抗体素子を配置

Profile High complete processing 520 秒  
Profile Low complete processing 280 秒

### 結果

すべての試験サンプルは、目視できるはんだ付け位置の検査に基づき、プロファイル高温および低温において重要なぬれ性を示した。

上記すべてのデータは、製品の特定保証特性ではありません。また特定のアプリケーションに適しているということではありません。データは2010年7月におけるテスト報告書からの抜粋です。

※このデータシートの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。技術データはガイドラインであり、特定の製品の特性を保証するものではありません。

お問い合わせ先:  
ヘラウス株式会社  
ヘラウス ネクセンソス部  
〒112-0012 東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル5F  
Tel: (03)6902-6596 Fax: (03)6902-6599  
Mail: nexensos.japan@heraeus.com URL: www.heraeus.co.jp